



**杭州立昂微电子股份有限公司
2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二二年六月

为提升公司核心竞争力，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂微”）拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次可转债发行募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 339,000 万元（含 339,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	建设地点	投资金额（万元）	使用募集资金（万元）	项目实施主体
1	年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目	衢州	230,233.00	113,000.00	金瑞泓微电子（衢州）有限公司
2	年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目	衢州	139,812.00	125,000.00	金瑞泓科技（衢州）有限公司
3	补充流动资金	-	101,000.00	101,000.00	-
合计		-	471,045.00	339,000.00	-

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目

1、项目概况

本项目拟投资 230,233.00 万元，由金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）作为实施主体，拟以募集资金投入 113,000.00 万元，通过新征土地，新建生产厂房、配套用房，购置外延炉、几何参数测试仪等国际先进

设备，建设“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”。项目建设期为 2 年，项目完全达产后，预计将形成年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片的生产能力，预计每年将实现销售收入 177,750.00 万元。

2、项目实施的背景及必要性

(1) 半导体硅片市场快速发展，大尺寸硅片仍占据主流

半导体硅片是占比最大的集成电路制造材料，根据 SEMI 统计，历年来半导体硅片的市场销售额占整个半导体材料市场总销售额的 32%-40%，半导体硅片的供应与价格变动对集成电路芯片产业存在较大影响。2017 年以来，受益于半导体终端市场需求强劲，下游传统应用领域计算机、移动通信、固态硬盘、工业电子市场持续增长，新兴应用领域如人工智能、区块链、物联网、汽车电子的快速发展，半导体硅片市场规模不断增长，并于 2018 年突破百亿美元大关，达到 114 亿美元；2019 年与 2020 年，市场规模仍维持在 112 亿美元的较高水平。

全球半导体硅片市场规模

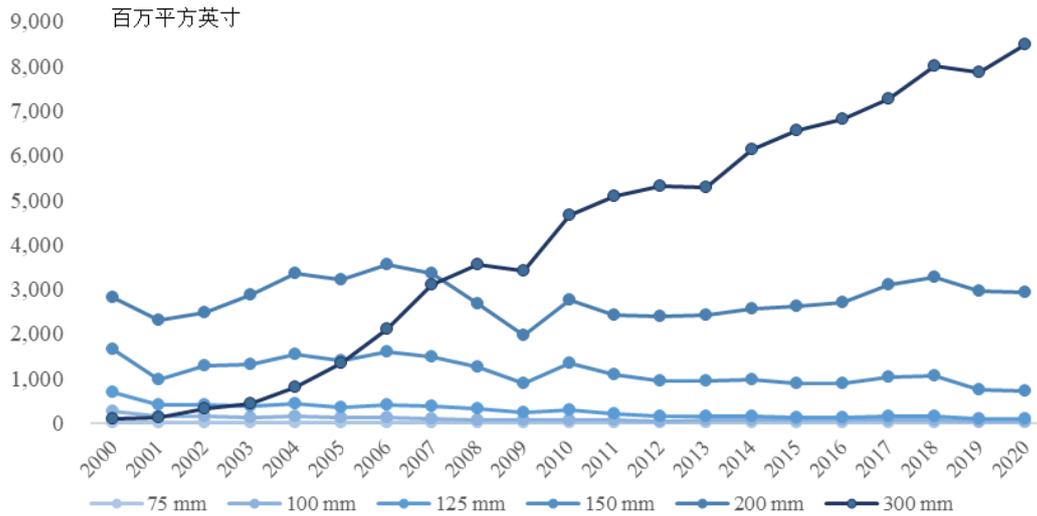


注：不包括 SOI 硅片

数据来源：SEMI

从半导体硅片规格来看，8 英寸、12 英寸直径的半导体硅片仍是目前全球市场的主流产品。其中，12 英寸硅片自 2000 年全球第一条制造生产线建成以来，市场份额逐步提高，于 2008 年首次超过 8 英寸硅片的市场份额；并且得益于移动通信、计算机等终端市场持续快速发展，其市场份额在 2019 年进一步提升至 67.22%，SEMI 预计到 2022 年市场份额将占据 80% 以上。

全球不同尺寸半导体硅片出货面积



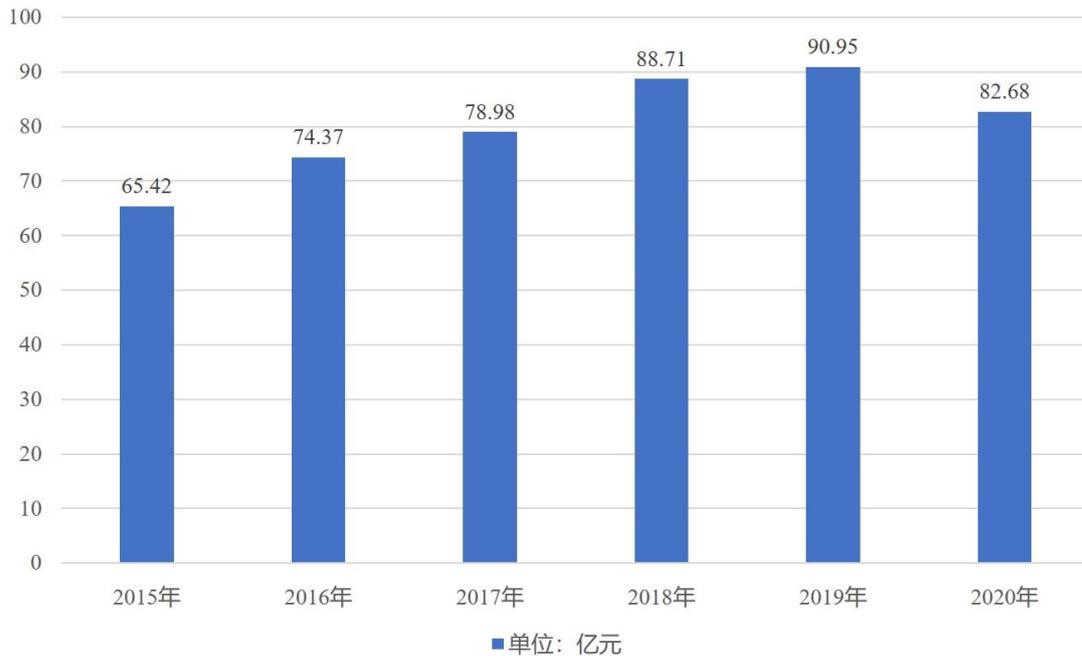
资料来源：SEMI

从半导体行业发展历程及前景来看，大尺寸半导体硅片是全球及国内半导体领域重点发展方向。本项目实施后，公司将进一步提升 12 英寸硅片在公司产品中的占比，提升公司的综合竞争力。

(2) 市场需求多元，下游应用发展带动半导体硅外延片需求增长

半导体硅外延片被大规模应用于对稳定性、缺陷密度、高电压及电流耐受性等要求更高的高级半导体器件中，主要包括 MOSFET、晶体管等功率器件，及 CIS、PMIC 等模拟器件，终端应用包括汽车、高端装备制造、能源管理、通信、消费电子等。随着新能源汽车、5G 通信、物联网、智能手机等行业的不断发展，半导体硅外延片市场规模持续增长。2016 年至 2019 年中国大陆半导体硅外延片市场规模从 65.42 亿元增长至 90.95 亿元，年均增长率为 6.3%；2020 年受疫情影响，中国半导体硅外延片市场规模减少至 82.68 亿元。然而，5G 通信技术、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩和工业互联网等新型基础设施均要大量使用功率器件和 CIS、PMIC 等模拟器件，预计未来上述相关领域投资建设规模的扩大将带动半导体硅外延片市场需求持续增长。

中国半导体硅外延片市场规模



资料来源：智研咨询

本项目的实施将有助于公司实现 12 英寸半导体硅外延片的大批量生产，在迎合多元化市场需求的同时，也能在一定程度上缓解市场供给的紧缺。

（3）加快进口替代，提高大尺寸半导体硅片国产化率

半导体硅片行业由于具有技术难度高、研发周期长、资金投入大、客户认证周期长等特点，其行业集中度较高。尤其在 12 英寸硅片的生产上，2020 年前五大硅片企业信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆和 SK Siltron 的市场份额高达 97%，市场垄断较为明显。目前，我国 12 英寸硅片的国产化率较低，主要依赖进口。随着下游需求的快速增长，国内大尺寸硅片的缺口将进一步扩大。因此，突破国外的技术封锁，掌握集成电路材料制造的核心技术是当前国内硅材料企业面临的主要挑战。

公司作为目前国内领先的半导体材料制造企业，已具备 12 英寸半导体硅片的生产技术基础。本项目的实施将有利于加快 12 英寸半导体硅片的进口替代进程，提高我国半导体硅片的自主化水平。

（4）优化公司产品结构，提升公司的综合竞争力

公司于 2021 年通过非公开发行股票募集资金投资“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目”大大增强了公司 12 英寸硅片的生产能力，但从产品品类上来说仍有不足，该项目在 180 万片 12 英寸硅抛光片的产能基础上仅配套了 120

万片 12 英寸硅外延片的生产能力。而通过本项目的实施，公司将新增年产 180 万片 12 英寸硅外延片的生产能力，可以使得公司产品结构得到进一步优化，从而进一步提升公司的综合竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 项目建设符合国家鼓励政策

半导体硅片行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。随着制造强国战略的提出，作为振兴民族半导体工业、促进国民经济转型的重要一环，各监管部门通过制定产业政策和颁布法律法规，从鼓励产业发展、支持研究开发、加强人才培养、知识产权保护等各方面，对半导体硅片行业发展给予大力扶持，本项目建设具备良好的政策背景支持。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，将瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发[2020]8 号）提出制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八方面政策措施，进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。

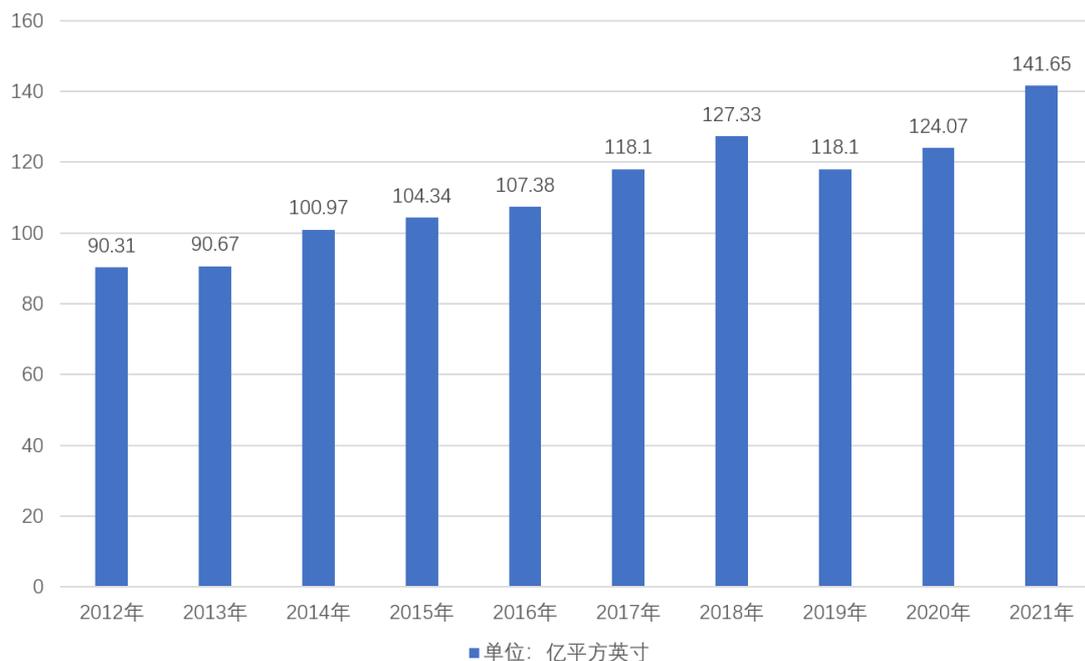
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）明确了 5 大领域 8 个产业，进一步细化到 40 个重点方向下 174 个子方向，近 4,000 项细分的产品和服务。其中包括：集成电路芯片产品、集成电路材料、电力电子功率器件及半导体材料等。

《工业“四基”发展目录（2016 年版）》将 8 英寸、12 英寸集成电路硅片列为新一代信息技术领域关键基础材料的首位。

(2) 行业前景广阔，下游需求增长为项目实施提供有力支持

根据 SEMI 统计，2021 年全球半导体硅片出货面积达 141.65 亿平方英尺，较 2020 年增长约 14.17%，突破 2018 年的历史高位，最近五年复合增长率达到 4.65%。

2012 年-2021 年全球半导体硅片出货面积



资料来源: Wind

半导体硅片行业的发展前景广阔, 下游需求持续增长, 随着未来 5G、云计算、大数据、人工智能等技术的大规模应用, 12 英寸硅片的需求将持续增长, 为本项目的实施提供了市场保障。

(3) 公司具备较强的技术研发实力

经过多年的积累, 公司已拥有一支高度专业化的技术团队, 主要研发人员具有在国内外知名半导体企业担任重要技术岗位的从业背景, 具有较强的自主研发和创新能力。公司在半导体硅片及半导体功率半导体芯片生产方面的核心技术具备行业领先性, 荣获国家技术发明奖二等奖、浙江省技术发明一等奖、中国半导体创新产品和技术奖等重要荣誉。目前公司已被认定为国家创新型试点企业, 设有省级重点企业研究院、市级院士工作站。

公司长期致力于技术含量高、附加值高的半导体硅片的研发与生产, 具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力。2004 年, 公司 6 英寸半导体硅抛光片和硅外延片开始批量生产并销售, 成为国内较早进行 6 英寸硅片量产的企业; 2009 年, 公司 8 英寸半导体硅外延片开始批量生产并销售, 实现我国 8 英寸硅片正片供应的突破; 通过承担十一五国家 02 专项, 公司具备了全系列 8 英寸硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片大批量生产制造的能力, 并开发了 12 英寸单晶生长核心技术, 以及硅片倒角、磨片、抛光、外延等一系列

关键技术，上述 8 英寸半导体硅片的大规模产业化和 12 英寸半导体硅片相关技术已于 2017 年 5 月通过国家 02 专项正式验收，标志着公司已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺研发的前列。凭借强大的研发团队以及深厚的技术积累，公司成为了行业中具有较强影响力的高新技术企业，为本项目的实施奠定了坚实基础。

4、项目投资概算

本项目投资总额为230,233.00万元，其中建筑工程及其他费用222,269.00万元，预备费1,491.00万元，铺底流动资金6,473.00万元。项目建设期为2年，具体投资安排如下：

单位：万元

项目	投资金额	占比	使用募集资金金额	是否为资本性支出
建筑工程及其他费用	222,269.00	96.54%	113,000.00	是
预备费	1,491.00	0.65%	-	否
铺底流动资金	6,473.00	2.81%	-	否
合计	230,233.00	100.00%	113,000.00	/

5、项目经济效益

本项目静态投资回收期（所得税后）为 6.21 年（含建设期），预计内部收益率（所得税后）为 19.61%，项目顺利实施将给公司带来良好收益，具备经济可行性。

6、项目用地情况及审批情况

本项目选址于浙江省衢州市绿色产业集聚区，金瑞泓微电子与衢州市自然资源和规划局于 2022 年 3 月 15 日签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号为 3308002022A21009）、于 2022 年 4 月 27 日签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号为 3308002022A21015）和《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号为 3308002022A21016），项目建设用地的不动产登记手续尚在办理过程中。

本项目已于 2022 年 4 月 2 日在衢州市智造新城衢州智造新城管理委员会办理了项目备案并取得了《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2201-330851-04-01-815719）。

本项目已于 2022 年 4 月 6 日取得衢州市生态环境局出具的“衢环智造建

[2022]17号”《关于金瑞泓微电子（衢州）有限公司年产180万片12英寸半导体硅外延片项目环境影响报告表的审查意见》，原则同意《金瑞泓微电子（衢州）有限公司年产180万片半导体硅外延片项目环境影响报告表（报批稿）》基本结论。

本项目已于2022年3月21日取得衢州市发展和改革委员会出具的“衢发改中[2022]13号”《关于金瑞泓微电子（衢州）有限公司年产180万片12英寸半导体硅外延片项目节能报告的审查意见》，原则同意《金瑞泓微电子（衢州）有限公司年产180万片半导体硅外延片项目节能报告》。

（二）年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目

1、项目概况

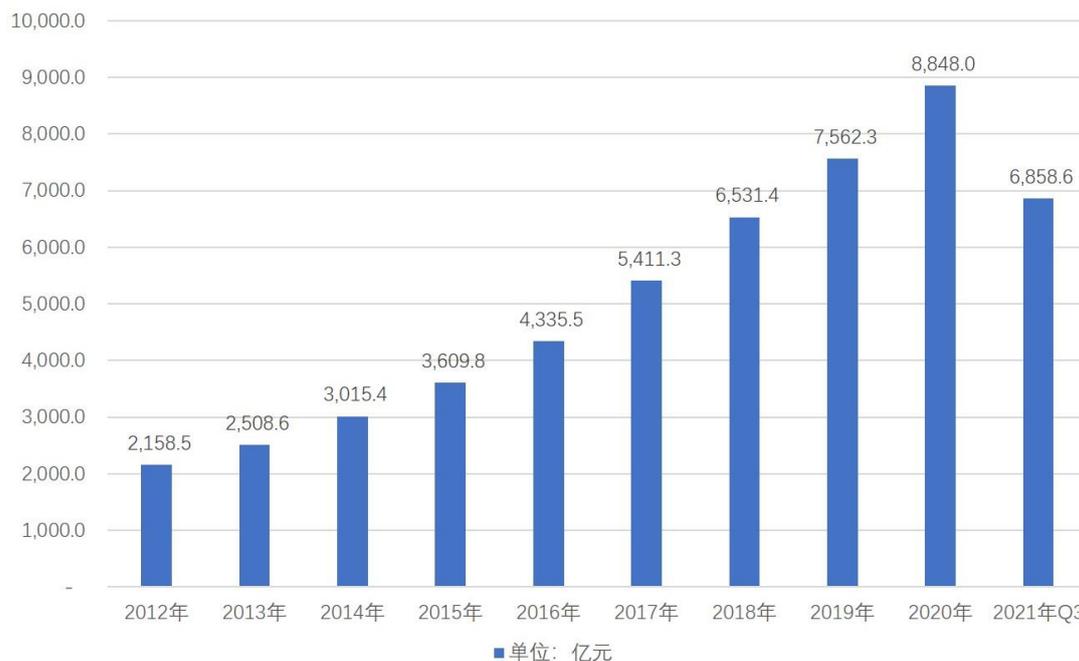
本项目拟投资139,812.00万元，由金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州金瑞泓”）作为实施主体，拟以募集资金投入125,000.00万元，利用厂区现有土地以及新增土地，新建生产厂房、配套用房，购置单晶炉、割断机、退火炉、多晶炉等设备，建设“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”。项目建设期为2年，项目完全达产后，预计形成年产600万片6英寸硅抛光片的生产能力，预计每年将实现销售收入66,000.00万元。

2、项目实施的背景及必要性

（1）半导体硅片需求强劲，8英寸及以下硅片应用空间依旧广阔

通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等终端应用领域的快速发展以及人工智能、物联网等新兴产业的崛起极大地促进了集成电路和功率半导体产业的发展，进而带动对上游半导体硅片需求的快速提升。近年来，我国集成电路和功率半导体市场规模持续扩大，2016年至2019年年均增速保持在20%以上。2020年，我国集成电路行业市场规模创下新高，达到8,848亿元，同比增长17%。2021年1月至9月达到约6,858.6亿元，同比增长16.1%。

中国集成电路行业市场规模



资料来源：中国半导体行业协会

在功率器件以及 PMIC、CIS 等模拟器件领域，8 英寸及以下半导体硅片依然是主流选择，由于产品的使用周期较长且需应用在高电压、大电流环境中，相关产品的技术发展方向主要在提高可靠性、降低失真、减少功耗、提高效率等方面，使用 8 英寸及以下半导体硅片有助于提升其质量稳定性及优化成本控制，预计未来上述领域的应用需求依然稳定。另外，考虑到国内 8 英寸及以下半导体硅片的制造工艺更为成熟，汽车、工业等领域等功率器件产品也首选前述尺寸的硅片作为基材，相关行业的旺盛需求也在驱动 8 英寸及以下半导体硅片的需求呈上涨趋势。

(2) 产品格局转换为国内 8 英寸及以下半导体硅片市场提供了机会

目前，国际市场上 12 英寸半导体硅片主要用于逻辑电路、存储器等半导体产品，而在模拟芯片、传感器及功率器件等领域，仍以 8 英寸半导体硅片为主，8 英寸及以下的半导体硅片市场需求也十分旺盛。由于发达国家主要对 12 英寸半导体硅片进行投资，6 至 8 英寸半导体硅片已不再新增产能，这为我国硅片生产企业占领 8 英寸及以下半导体硅片市场份额提供了机会。

(3) 巩固半导体硅片市场地位，增强盈利能力

公司目前半导体硅片产品以 8 英寸及以下规格为主，产品技术成熟、质量稳定。随着我国高端功率半导体及集成电路产业对材料的本地化供应要求日益迫

切，以及下游市场需求的持续增长，公司现有半导体硅片生产线的产能利用率已较高。本项目实施后，公司将实现新增年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片的产能规模，将显著提升市场中 6 英寸硅片的供应量，以填补日益增长的市场需求，巩固市场头部地位，提升综合竞争力。

（4）增加公司 6 英寸硅片的前道工序产能，大力提升公司的盈利能力

2019 年以来，随着市场对 6 英寸硅片的旺盛需求，公司的 6 英寸硅片产品已历经数次提价，盈利能力大幅增加。公司于 2021 年通过非公开发行股票募集资金投资“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”大大增加了公司 6 英寸硅外延片的生产能力，但随着市场上对 6 英寸硅外延片和其前道工序产品硅抛光片的旺盛需求，公司现有的 6 英寸硅抛光片的产能已无法完全满足同时保证 6 英寸硅抛光片的对外出货和作为硅外延片的衬底（即作为硅外延片的原材料）需求。而通过本项目的实施，公司将新增年产 600 万片 6 英寸硅抛光片的生产能力，从而充分满足 6 英寸硅抛光片的对外出货和作为硅外延片的衬底需求，进一步公司的盈利能力。

3、项目实施的可行性

（1）公司具有较强的行业影响力

公司是我国技术先进和规模领先的半导体硅片生产厂商，先后承担并成功完成了科技部国家 863 计划、国家火炬计划、国家发改委高技术产业化示范工程、信息产业技术进步与产业升级专项、工信部电子信息产业发展基金、集成电路产业研发专项资金等国家重大科研项目。公司牵头承担的国家 02 专项“200mm 硅片研发与产业化及 300mm 硅片关键技术研究项目”于 2017 年 5 月通过国家正式验收。在近几年中国半导体材料十强企业评选中，公司连续蝉联第一名。作为国内主要的半导体硅片生产厂商之一，公司具有较高的行业地位及较强的行业影响力，为本项目的顺利实施提供了基础保障。

（2）公司具有完善的生产及销售体系

公司制定了详细的质量控制制度，且通过了 ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001:2015 等质量管理体系认证，对产品生产和销售全过程实施严格的质量控制。公司引进了国内外先进的生产、检测、试验设备，对产品的原料采购、生产、出货进行了严格的程序化、流程化管理，确保质量控制体系的持续性和有效

性，为公司高效生产和质量保障奠定了坚实基础。

目前，公司能够按照国际 SEMI 标准、中国国家标准、销售目的地国家标准及客户特定要求控制产品质量。在严格的质量控制体系和高标准的品质保证之下，公司努力开发国内外高端客户，包括 AOS、日本东芝公司、台湾汉磊等国际知名跨国公司，同时公司也是中芯国际、华虹宏力、华润微电子等国内相关企业的重要供应商，通过了上述公司对产品质量体系、产品工艺和产品质量的严格审核和认证，为公司产品的顺利销售提供了前提条件。

4、项目投资概算

本项目投资总额为139,812.00万元，其中建筑工程及其他费用133,581.00万元，预备费1,894.00万元，铺底流动资金4,337.00万元。项目建设期为2年，具体投资安排如下：

单位：万元

项目	投资金额	占比	使用募集资金金额	是否为资本性支出
建筑工程及其他费用	133,581.00	95.54%	125,000.00	是
预备费	1,894.00	1.35%	-	否
铺底流动资金	4,337.00	3.10%	-	否
合计	139,812.00	100.00%	125,000.00	/

5、项目经济效益

本项目静态投资回收期（所得税后）为 7.80 年（含建设期），预计内部收益率（所得税后）为 13.15%，项目顺利实施将给公司带来良好收益，具备经济可行性。

6、项目用地情况及审批情况

本项目选址于浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号，衢州金瑞泓与衢州市自然资源和规划局于 2022 年 4 月 27 日签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号为 3308002022A21014），部分项目建设用地的不动产登记手续尚在办理过程中。

本项目已于 2022 年 5 月 18 日在衢州市智造新城衢州智造新城管理委员会办理了项目备案并取得了《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2201-330851-04-01-980976）。

本项目已于 2022 年 4 月 6 日取得衢州市生态环境局出具的“衢环智造建

[2022]16号”《关于金瑞泓科技（衢州）有限公司年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目环境影响报告表的审查意见》，原则同意《金瑞泓科技（衢州）有限公司年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目环境影响报告表（报批稿）》基本结论。

本项目已于2022年3月21日取得衢州市发展和改革委员会出具的“衢发改中[2022]15号”《关于金瑞泓科技（衢州）有限公司年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目节能报告的审查意见》，原则同意《金瑞泓科技（衢州）有限公司年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目节能报告》。

（三）补充流动资金

1、项目概况

公司拟使用本次募集资金中的101,000.00万元补充流动资金，以满足业务发展的流动资金需求，同时优化资本结构，增强公司抗风险能力，提升公司整体盈利能力。

2、项目的必要性与合理性

（1）增强资金实力，满足公司经营规模和主营业务增长的需要

近年来，公司业务呈现快速增长的趋势，2019年度、2020年度、2021年度营业收入分别为119,168.60万元、150,201.78万元、254,091.62万元，收入规模整体呈增长态势。随着公司经营规模的不断扩大，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金迅速增加，公司除了要进行生产厂房建设、生产设备的购置等固定资产投资外，还需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动。补充流动资金将有利于提高公司的综合经营实力，增强公司的市场竞争力。

（2）优化资本结构、降低财务费用，提高公司抗风险能力

截至2022年3月末，公司合并口径资产负债率为39.50%，合并报表有息负债达到24.30亿元，占总负债的比例为43.17%。使用本次募集资金补充流动资金后，公司的偿债能力将得到提高，抗风险能力将进一步增强，公司的资产负债率能够逐步降低。同时，通过补充流动资金可以减少未来公司的银行贷款金额，从而降低财务费用，减少财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利水平，增强公司长期可持续发展能力。

2019 年至 2022 年 3 月末，公司与可比上市公司主要偿债指标对比如下：

财务指标	证券代码	证券简称	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率	688396.SH	华润微	3.94	3.41	3.60	2.57
	600360.SH	华微电子	1.24	1.13	1.63	1.86
	600460.SH	士兰微	1.50	1.37	1.19	1.13
	300373.SZ	扬杰科技	1.81	2.16	2.11	2.18
	688126.SH	沪硅产业	4.79	1.89	2.36	0.74
	003026.SZ	中晶科技	2.38	2.24	8.22	4.02
	002129.SZ	中环股份	1.10	1.20	0.93	1.04
	行业平均		2.39	1.91	2.86	1.93
	本公司		2.14	3.19	1.83	1.07
速动比率	688396.SH	华润微	3.56	3.05	3.18	2.04
	600360.SH	华微电子	1.15	1.06	1.50	1.75
	600460.SH	士兰微	1.05	0.99	0.81	0.71
	300373.SZ	扬杰科技	1.35	1.63	1.66	1.77
	688126.SH	沪硅产业	4.35	1.41	1.97	0.54
	003026.SZ	中晶科技	1.94	1.83	7.36	2.90
	002129.SZ	中环股份	0.88	1.04	0.80	0.94
	行业平均		2.21	1.57	2.47	1.52
	本公司		1.74	2.77	1.51	0.82
资产负债率	688396.SH	华润微	22.24%	21.14%	28.62%	36.70%
	600360.SH	华微电子	53.32%	52.55%	48.95%	45.96%
	600460.SH	士兰微	48.30%	48.51%	54.20%	52.45%
	300373.SZ	扬杰科技	33.53%	29.22%	26.46%	25.25%
	688126.SH	沪硅产业	29.45%	35.45%	34.20%	48.06%
	003026.SZ	中晶科技	34.93%	29.18%	11.45%	18.83%
	002129.SZ	中环股份	46.43%	46.56%	52.18%	58.17%
	行业平均		38.31%	37.52%	36.58%	40.77%
	本公司		39.50%	34.39%	60.59%	58.82%

由上表可见，2019 年末及 2020 年末，公司的流动比率、速动比率均显著低于同行业上市公司平均值，资产负债率则显著较高，公司的流动资金较为紧张，财务压力较大；2021 年，公司非公开发行股票并募集约 52 亿元资金，形成了较

大的资产及股东权益增加，导致当年末资产负债率大幅下降，而流动比率和速动比率则大幅提升。公司所处行业特点和业务模式决定了公司对资金的需求量较大。首先，半导体硅片及半导体分立器件行业属于资金密集型行业，一条生产线的厂房及设备投资动辄上亿元，大规模的固定资产投资需要大量资金；其次，公司产品尺寸、品种及型号众多且主营业务产业链较长，为保证产成品的及时交货以及主要原材料的持续稳定供应，公司通常需保有一定数量的原材料备货；再次，公司目前销售端的平均账期长于采购端的资金结算账期也形成了对资金的一定占用。综上所述，公司本次使用募集资金补充流动资金具有必要性。

三、募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募集资金将投向于公司主业，有利于公司实现业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业的领先地位，符合公司长期发展需求。本次发行后，公司的主营业务范围保持不变，经营规模进一步扩大，市场份额进一步提升。本次公开发行可转债是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。

（二）对公司财务状况的影响

本次公开发行可转债完成后，公司的总资产和净资产规模将有所增长，整体资产负债率水平得到降低，有利于优化资本结构，降低财务风险，为公司业务的进一步发展奠定坚实的基础。

另一方面，由于募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目的建成和运行，公司的主营收入与利润规模将有所增长，为股东投入带来回报。

四、可行性分析结论

综上所述，公司本次公开发行可转债的募集资金投向符合国家产业政策、行业发展方向以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。通过本次募投项目的实施，将进一步丰富公司产品线，增强公司综合竞争力，优化公司资本结构，提升抗风险能力，有利于公司可

持续发展，符合全体股东的利益。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022年6月2日